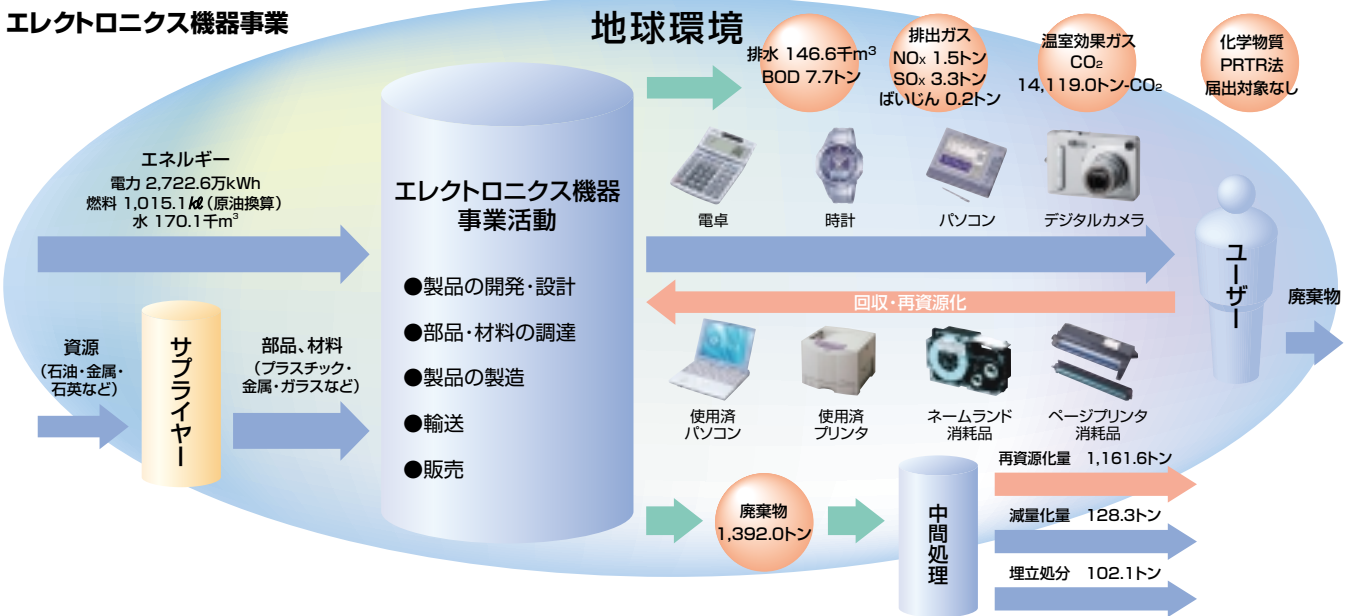
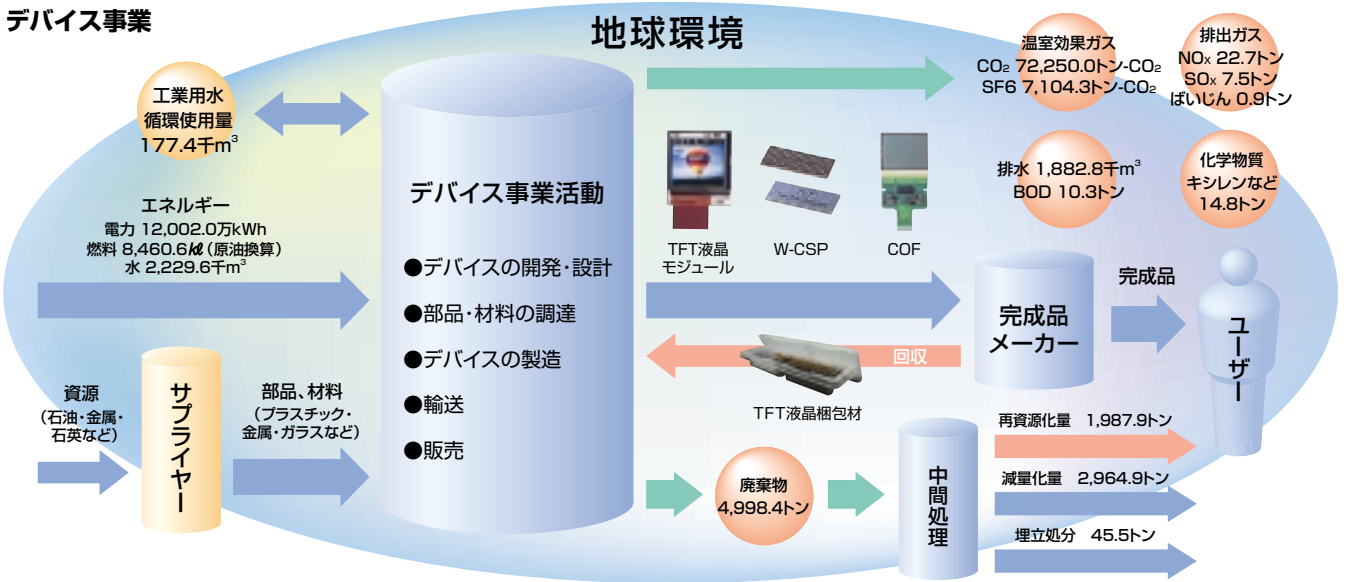


カシオグループのインプットとアウトプット

カシオグループの事業活動は、デバイス事業とエレクトロニクス機器事業に分かれます。それぞれの事業における物質とエネルギーの投入・排出による環境負荷を測定しました。

※デバイス事業は国内4拠点、エレクトロニクス機器事業は国内8拠点を対象としています。



カシオグループのデバイス事業は、高知カシオのTFT液晶モジュール、カシオマイクロニクスのW-CSP、COF、甲府カシオのLCDが主な生産品目です。これらの事業所では、微細加工に必要なクラスの高いクリーンルーム、洗浄のための純水装置及びその排水処理施設を設置しています。このため、カシオグループ全体のエネルギー消費の約8割を使用しているほか、水や薬液なども

エレクトロニクス機器事業に比べて多く消費しています。

生産工場では積極的に省エネや節水活動に取り組み、カシオマイクロニクスでは、工程洗浄排水を循環利用することにより、市水の使用を大幅に削減しました。

エレクトロニクス機器事業は、中国をはじめとした海外へ生産を移管する一方、デジタルカメラ、携帯電話、ページプリンタ他品

目を国内で生産しています。これらの生産には高度な組立技術が必要としますが、それに伴い多くのエネルギーも消費します。そこで製品設計の段階で、組立時の省エネ、省資源などを製品アセスメントの中に取り入れて、環境に配慮した製品づくりを実施する一方、生産工場独自の工夫も盛り込んで省エネに取り組んでいます。

用語解説

W-CSP (ウエハー・レベルCSP)

ウエハー・レベルCSPは、LSIのパッケージ工程として、ウエハー状態のまま、銅の再配線形成、電極端子形成と樹脂封止を行った後、チップサイズに切り出す先端技術。この技術の利点は、チップとまったく同じ寸法までパッケージを小型化できること。

COF

Chip on Film の略。薄い樹脂製フィルムにLSIチップを直接接合する実装方式で、限られたスペースにLSI回路を効率的に、高密度に実装することが可能。